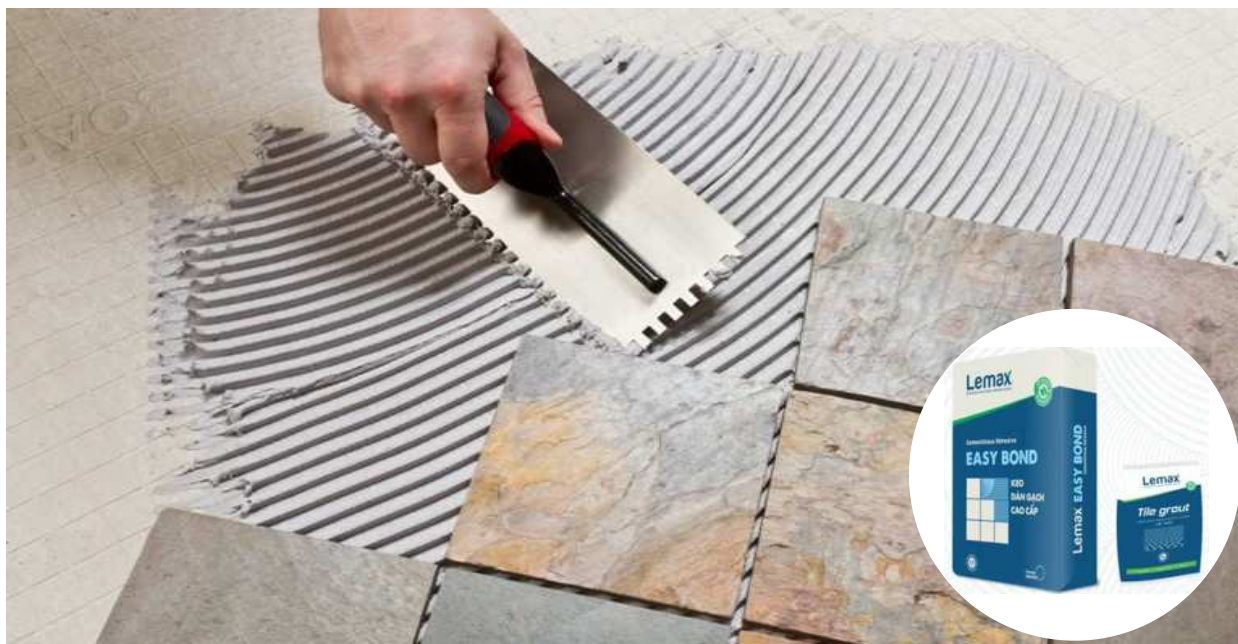


GIẢI PHÁP THI CÔNG

Keo ốp lát Lemax Easy Bond và keo chít mạch Lemax Tile grout



Phạm vi

Lemax Easy Bond Thích hợp ốp và lát các loại gạch Ceramic, Granite, Mosaic, đá tự nhiên, gạch gốm... có kích thước & độ hút nước trung bình, ở khu vực nội thất hoặc ngoại thất có mái che. Khu vực có độ ẩm cao như nhà tắm, nhà bếp...

Mô tả sản phẩm

Lemax Easy Bond là keo ốp lát gốc xi măng đạt chuẩn chất lượng C1 theo tiêu chuẩn TCVN 7899-3:2008 & ISO 13007-3:2004, với nhiều tính năng ưu việt.

Ứng dụng

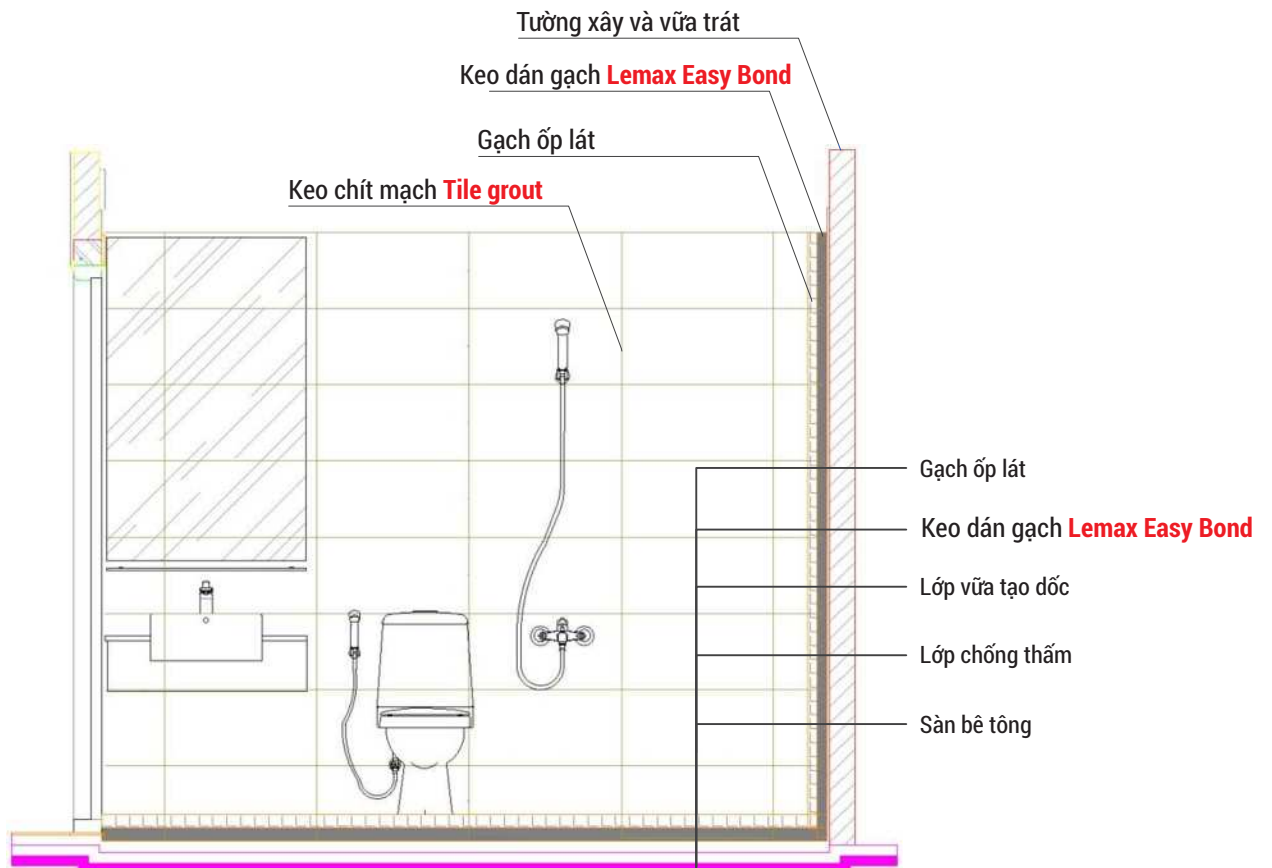
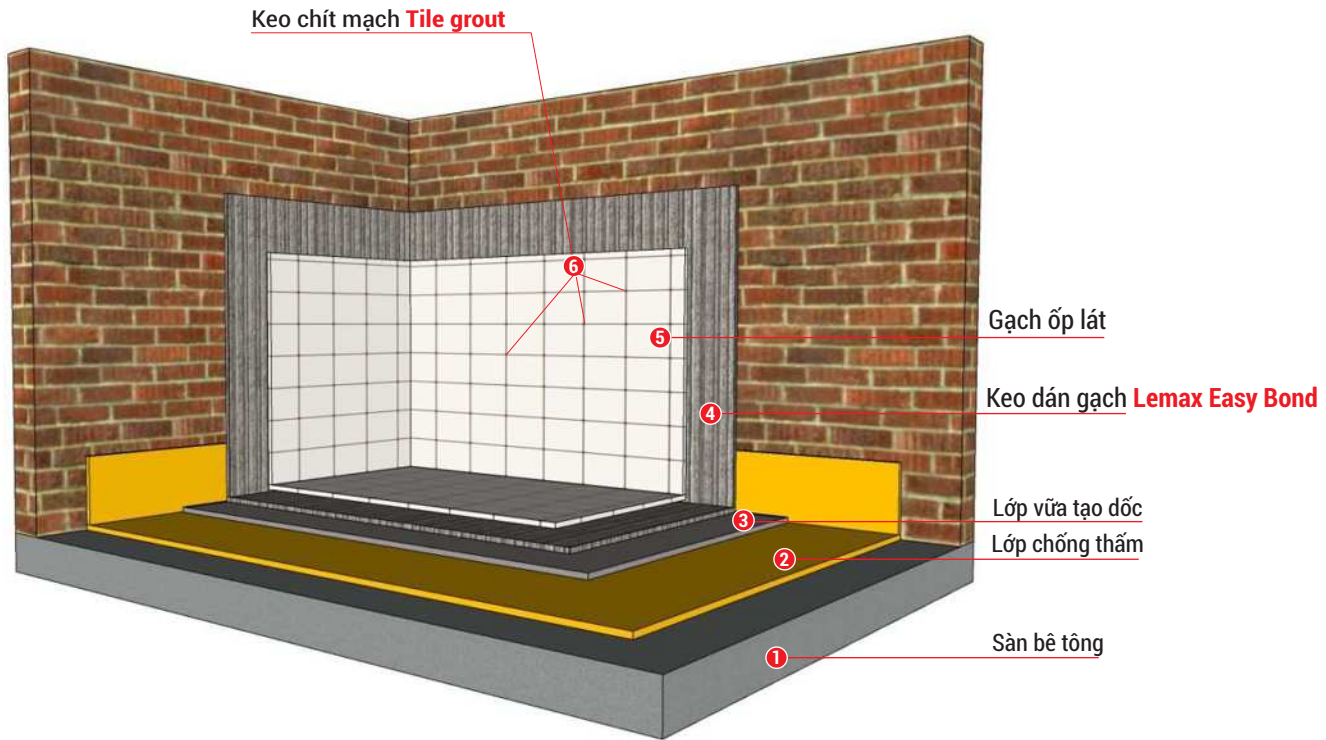
Dùng để ốp lát sàn hoặc tường có lớp vữa trát thông thường hoặc vữa xi măng, ốp lát khu vực nội thất, khu vực ngoại thất ít chịu tác động do thay đổi nhiệt độ đột ngột, tấm bê tông, tấm thạch cao đã được xử lý bằng lớp lót chuyên dụng.

Đặc tính ưu điểm

- Cường độ bám dính cao
- Không co ngót, không bong bộp
- Chống thấm tốt
- Sử dụng thuận tiện, tiết kiệm
- Rút ngắn tiến độ thi công
- Thân thiện với môi trường và người sử dụng








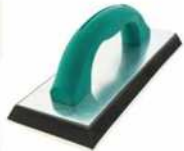

Keo ốp lát Lemax Easy Bond và keo chít mạch Lemax Tile grout

Cấu tạo hệ thống



Keo ốp lát Lemax Easy Bond và keo chít mạch Lemax Tile grout

Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

		
Keo ốp lát, keo chít mạch	Thùng trộn vật liệu	Bay răng cưa
		
Máy khuấy	Ke góc	Ke cân bằng
		
Búa cao xu	bay chà ron	Chổi vệ sinh

Thi công

• THI CÔNG Keo ốp lát Lemax Easy Bond và keo chít mạch Lemax Tile Grout

▪ Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt thi công phải bằng phẳng, cứng chắc, không có tạp chất, dầu mỡ, sập và khô ráo.
- Các bề mặt gốc xi măng phải không co ngót sau khi thi công ốp lát và phải được bảo dưỡng đầy đủ, đúng cách.
- Làm mát bề mặt bằng nước nếu bề mặt bị nóng quá do tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Bề mặt thạch cao phải khô hoàn toàn, cứng chắc, không có bụi bẩn và phải được xử lý bằng lớp lót chuyên dụng.

▪ Trộn

- Dùng máy khuấy ở tốc độ thấp trộn **Lemax Easy Bond** với nước sạch để tạo thành hỗn hợp vừa dẻo và không vón cục, chú ý cho nước vào xô trước & đổ từ từ keo vào sau. Để khoảng 3-5 phút cho Polymer và phụ gia phát huy hết tác dụng, trộn lại và sử dụng bình thường.
- Tỷ lệ nước trộn là 22%-24% tính theo khối lượng.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì.
- Thời gian sử dụng của hỗn hợp keo sau khi trộn là 4 tiếng.

Keo ốp lát Lemax Easy Bond và keo chít mạch Lemax Tile grout

▪ Thi công keo

- **Lemax Easy Bond** được thi công bằng bay răng cưa lên bề mặt nền ốp lát. Chọn loại bay răng cưa thích hợp có khả năng phủ 65-70% diện tích mặt sau của viên gạch khi ốp tường hoặc khu vực cho phép lưu thông nhẹ ở trong nhà. Đối với khu vực có mật độ lưu thông lớn và ở ngoài trời, nên sử dụng loại bay răng cưa có diện tích che phủ 100% diện tích viên gạch.
- Để đạt được độ bám dính tối ưu nhất của gạch lên bề mặt ốp lát, cần tuân thủ phương pháp thi công sau:
 Đầu tiên, dùng cạnh thẳng của bay răng cưa trải một lớp **Lemax Easy Bond** có chiều dày thích hợp (tùy thuộc vào kích thước và chiều dày viên gạch) lên bề mặt ốp lát, sau đó dùng cạnh răng cưa kéo một góc nghiêng 45 độ tạo các đường rãnh có độ dày thích hợp và đồng đều trên bề mặt lớp vữa ốp lát.
- Trường hợp ốp lát gạch lên tường và sàn ngoài trời chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt (nắng nóng, sương giá...) khu vực bề bơi, sàn chịu tải trọng nặng, khu vực khó thi công hoặc gạch có kích thước lớn hơn 90cm²... nên dùng bay răng cưa trải đều **Lemax Easy Bond** lên cả mặt sau của viên gạch.

▪ Ốp lát gạch

- Không cần làm ẩm gạch trước khi ốp lát. Nếu mặt sau của gạch quá bẩn, cần rửa gạch trong nước sạch và để ráo nước trước khi thi công.
- Dùng búa cao su gõ nhẹ lên viên gạch khi ốp lát để đảm bảo độ tiếp xúc tuyệt đối giữa gạch với keo.
- Thời gian thi công (thời gian mở) của keo ốp lát **Lemax Easy Bond** là 20 đến 30 phút ở nhiệt độ bình thường. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi (nắng to, hanh khô, nhiệt độ cao...) hay với các bề mặt có độ thấm hút cao, thời gian cho phép thi công có thể bị rút ngắn.
- Khi thi công cần chú ý kiểm tra tránh việc tạo thành một lớp màng khô mỏng trên bề mặt vữa, trong trường hợp này nên dùng bay cào làm lại vữa mới, không dùng nước vì có thể ảnh hưởng tới khả năng bám dính của vữa.
- Nên làm ẩm bề mặt và để ráo trước khi thi công để duy trì thời gian thi công vữa.
- Việc điều chỉnh vị trí gạch, nếu cần, có thể được thực hiện trong vòng 20 phút sau khi ốp lát.
- Lớp gạch ốp lát bằng **Lemax Easy Bond** phải được bảo vệ khỏi bị rửa trôi hoặc mưa thấm dột trong ít nhất 24 tiếng và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi thi công.

▪ Chít mạch

- Mạch vữa trên tường có thể được có thể được chít bằng **Lemax Tile Grout** sau 4-8 tiếng và mạch vữa trên sàn có thể được chít sau 12 tiếng sau khi thi công.
- Dùng khăn ẩm lau sạch bề mặt gạch sau khi chít mạch vài giờ.
- Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: sau 24 tiếng
- Thời gian cho phép đưa vào sử dụng: sau 14 ngày

▪ Vệ sinh

- Rửa sạch dụng cụ thi công và thùng chứa bằng nước sạch trước khi keo khô.

▪ Định mức sử dụng

<i>Kích thước gạch (mmxmm).</i>	<i>Định mức tương đối (kg/m²).</i>
≤200x200	2-3 kg/m ²
300x300, 400x400	4-5 kg/m ²
300x600, 600x600	6-8 kg/m ²
600x900, 800x800	8-10 kg/m ²

▪ Lưu ý

- Lượng dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ phẳng của cốt nền, tay nghề của thợ thi công, dụng cụ và phương pháp thi công.

Keo ốp lát Lemax Easy Bond và keo chít mạch Lemax Tile grout

▪ Đóng gói, bảo quản và hạn sử dụng

- Lemax Easy Bond được đóng gói trong bao 3 lớp chống ẩm, trọng lượng 25kg/bao.
- Bảo quản nơi khô thoáng, không xếp chồng cao quá 10 bao trong thời gian dài.
- Hạn sử dụng 12 tháng từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.

▪ Hướng dẫn an toàn

- Lemax Easy Bond có chứa xi măng, do vậy có thể gây kích ứng cho da khi tiếp xúc với mồ hôi.
- Nên mang găng tay và kính bảo hộ khi thao tác, nếu sơ ý bị bắn vào mắt, cần rửa dưới vòi nước sạch nhiều lần và tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Hình ảnh các bước thi công

(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)



Vệ sinh bề mặt



Trộn keo dán gạch



Ốp lát gạch



Chít mạch